8.2.2 Merkpunkte zu Kapitel 8.2: Einkristallverformung als Modell

- Bei einem für *Einfachgleitung* ortientiertem Einkristall (<123> Orientierung für **fcc** Gitter) wird bei Erhöhen der Spannung zunächst nur auf einer Gleitebene **T**krit überschritten.
- Obwohl nur von geringer praktischer Bedeutung, zeigt der Versuch sehr deutlich was bis zum Bruch geschieht:
 - Elastische Verfomung bis zu R_p, d.h. bis zum Erreichen von T_{krit} auf der "günstig" orientierten Gleitebene.
 - "Weiches" Verhalten im Bereich I, da Versetzungen auf der betätigten Gleitebene jetzt laufen können und große plastische Verformung ermöglichen.
 - Die blockweise Abgleitung ist (im Mikroskop) gut sichtbar.
 - Verfestigung (d.h. "hartes" Verhalten) im Bereich II, weil durch die gestiegene Spannung jetzt auch andere Gleitsysteme betätigt werden, und die Versetzungen sich gegenseitig behindern, d.h. nicht mehr leicht laufen können.
 - Entfestigung im Bereich III (Kristall ist wieder "weich"), weil bei den jetzt sehr hohen Spannungen Versetzungen sich von Hindernissen "losreißen" können.
 - Schließlich Bruch auch weil der Kristall jetzt sehr lang, und damit auch viel dünner geworden ist.
- Damit ist auch klar, wie sich Einkristalle verformen, die so orientiert sind dass mehrere Gleitebenen gleichzeitig aktiviert werden (z.B. <100> Orientierung von fcc Gittern):
 - Bereich II wird praktisch von Anfang an vorliegen.
- Für Polykristalle, deren Körner "statistisch" orientiert sind, d.h. keine Vorzugsrichtungen haben, werden wir ähnliches Verhalten erwarten.
 - Damit haben wir dann "klassische" Spannungs Dehnungskurven von technischen Materialien im Prinzip verstanden!
 - Dass die Realität noch erheblich komplizierter ist, versteht sich dabei von selbst.



